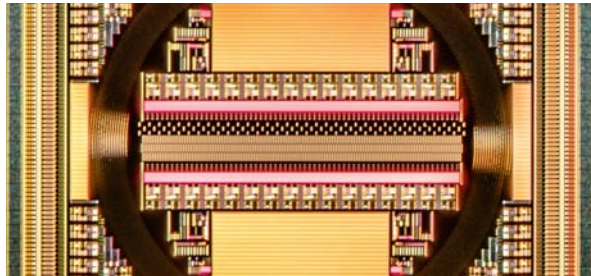
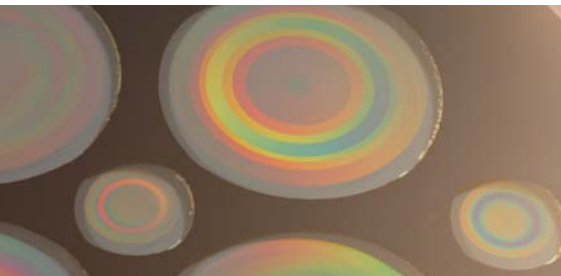


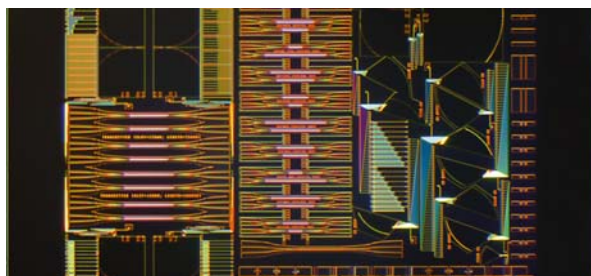
Chip-Film Patch mit ASIC



Opto-Mixed-Signal-ASIC



Membranwafer für Brennstoffzelle auf Si-MEMS-Basis



Photonik-Chip

- 1.400 m² Reinraum ISO04
- Vollständige Front- und Backend-of-Line Prozesslinie mit Si-Epitaxie, Abscheidungs-, Metallisierungs- und Ätzequipment
- GaN-on-Si Technologielinie für 150 und 200 mm Wafer (CMOS-kompatibel)
- Maskenfertigungslinie für 6, 9, 12 und 17 Zoll (430 mm) Substrate
- Lithografie (i-Line Stepper, Laserdirektschreiben und Elektronenstrahldirektschreiben sowie Rückseiten- und Proximitybelichtung)
- Aufbau- und Verbindungstechniken mit Waferbearbeitung bis 200 mm inklusive Rückdünnen
- Test- und Qualitätsumgebung



Institut für Mikroelektronik Stuttgart

Allmandring 30 a, 70569 Stuttgart, Germany

Ansprechpartnerin: Christine Harendt

Telefon +49 711 21855 - 403 • harendt@ims-chips.de • www.ims-chips.de



**Aus einer Hand
von der Idee
bis zum Produkt**

Institut für Mikroelektronik Stuttgart

IMS CHIPS



Seit über 30 Jahren entwickeln wir im Bereich der Mikroelektronik und Nanotechnologie verschiedenste Anwendungen und Prozesse sowohl für die Forschung als auch für die Industrie. Mit unserem modernen Anlagenpark und einem starken Partnernetzwerk finden wir Lösungen für Ihre Produkte und Ihre Ideen.

Kompetenzen

- ASIC-Design und Foundry-Fertigung
- Bio-Medizinelektronik
- Industrie 4.0
- Mikrosysteme

- Bildsensoren und Kameras
- CMOS Bildsensoren
- Berührungslose (Hoch-) Temperaturmessung

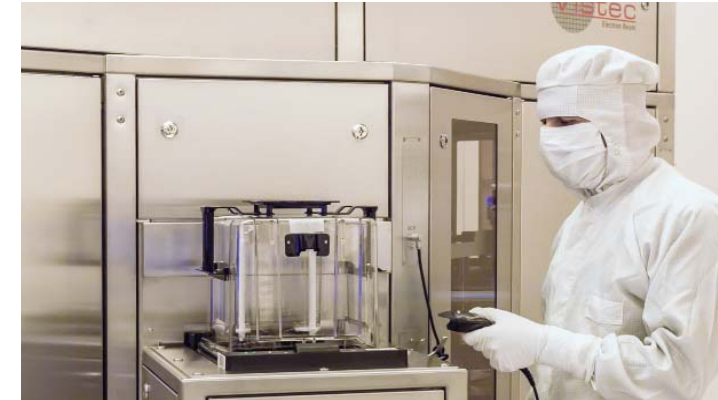
- Silizium Prozesse
- Hybride Systeme in Folie
- GaN-Technologie

- Silizium Photonik

- Membran Prozesse

- 3D-Replikationsmaster
- Diffraktive und optische Komponenten (z.B. CGH)
- Photomasken

Leistungsspektrum



- Qualifizierte Einzelprozesse und Prozessketten für Silizium-, GaN-on-Si- und Quarzwafer bis 200 mm
- Advanced Packaging Prozesse für hybride Foliensysteme mit eingebetteten Siliziumchips
- Bearbeitung von 6, 9 und 12 Zoll Quarzmasken sowie Quarzsubstraten mit einem Durchmesser von 430 mm
- Design und Fertigung von Silizium Photonik Komponenten
- IECQ und ISO 9001 Zertifizierung (Prozess-zertifizierung nach ISO 90001, Hersteller von Mikrochips nach IECQ)

Einzelprozessliste: https://www.ims-chips.de/wp-content/uploads/2020/12/Faltblatt_Halbleiterintegration_2020.pdf

